

「第3回 ネプコンジャパン秋」に出展致します

— 会期:2024年9月4日(水)~6日(金) —

是非、弊社ブースへお立ち寄りください [2ホール 4-26]

先進の技術で不可能を可能に!

～ニホンゲンマのスーパーファインテクノロジー～

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社は、来る2024年9月4日(水)～6日(金)幕張メッセホール1～3において開催されます「第3回ネプコンジャパン秋」に出展する運びとなりました。ここに謹んでご案内申し上げます。

弊社ブースでは、

「3D構造組立へ! 微細ディスペンス用はんだペースト」「接合部の超微細化へ! 超微細はんだ粉末Type9(1～5μm)適用製品」「車載、高信頼性製品に対応! 超低ボイドペースト」「スルーホールリフローに対応! レーザー用ペースト」「半導体パッケージ向け製品! 水溶性はんだペースト、エポキシ樹脂系はんだペースト」「組立後の洗浄工程削減へ! 残渣レス、ギ酸対応はんだペースト」「環境負荷低減! 低融点ペースト」等の各種鉛フリー新商品を展示致します。

弊社は、はんだゾーン小間番号: 2ホール 4-26 にて出展致しております。ご多忙のこととは存じますが、是非この機会にご来場賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

ご来場にはお一人様1枚招待券が必要です。招待券はこちらよりダウンロードをお願い致します。《<https://www.nepconjapan.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1096465280478050-24A>》

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

株式会社ニホンゲンマ  
代表取締役社長 川崎 誠

追記 下記アポイントメント票を用意致しました。恐れ入りますがご来場予定日時をご記入の上、出来ましたら2024年9月3日までにご返送あるいは、弊社営業担当者までご返却願いたく宜しくお願い申し上げます。

キリトリ

TO: 株式会社ニホンゲンマ  
営業部 木元宛

返送先 FAX : 03-3863-5722  
E-MAIL : kimoto@genma.co.jp

アポイントメント票

貴社名 \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_  
FAX: \_\_\_\_\_

ご芳名 \_\_\_\_\_ 役職: \_\_\_\_\_

ご来場予定日時: 2024年9月 日 時



エレクトロニクス時代を支える

株式会社 ニホンゲンマ